

平成 24 年度保物セミナー参加申込書（一般用）

受付番号^{注1)}

送付先：Fax. 06-6262-6525 E-mail：seminar@esi.or.jp

主 催：平成 24 年度保物セミナー実行委員会

〒541-0057 大阪府中央区北久宝寺町 2-3-6

電子科学研究所内 Tel.06-6262-2410

会 場：大阪科学技術センター 大ホール

〒550-0004 大阪府西区靱本町 1-8-4 Tel.06-6443-5320

開催日：平成 25 年 2 月 1 日（金） 9 時 30 分～17 時 30 分

ボイリングディスカッション：18 時 00 分～20 時 00 分

ボイリング会場：大阪科学技術センター 7F レストラン

平成 24 年度保物セミナー参加申し込みます

勤務先		所属部署		
住所 〒				
Tel.		Fax.		
E-mail				
(ふりがな) 氏 名		セミナー (3,000 円)	ボイリング (5,000 円)	支払方法 ^{注2)}
		参加・不参加	参加・不参加	当日・振込
		参加・不参加	参加・不参加	当日・振込
		参加・不参加	参加・不参加	当日・振込
		参加・不参加	参加・不参加	当日・振込
		参加・不参加	参加・不参加	当日・振込
ご意見欄				

注 1) 申込書を送付頂けますと受付番号を記入して Fax.またはEメールにてご返送いたします。

セミナー当日は、受付番号が記載された申込用紙を印刷してお持ちください。

注 2) お振込の場合は、平成 25 年 1 月 20 日までに下記銀行口座にお振り込み下さい。(お振り込み後の返金
はご容赦ください)

銀行名・口座 三菱東京 UFJ 銀行 ^{ニッポンイテ} 日本一 支店 (店番 034) 普通 0053653

口座名義 ^{ザイダンホウジン} 財団法人 ^{デンシカガクケンキュウシヨ} 電子科学研究所